

技術ロードマップ(PCB)

開発案件

(単位: μm)

◆高周波・通信(基地局、サーバー向け)



項目	2021年		2023年	
	標準	チャレンジ	標準	チャレンジ
段数	3段	4段	4段	5段
L/S	75/75	50/75	50/75	40/40
Impedance Control	75/100	75/100	75/100	40/60
L/VH径	$\Phi 100$	$\Phi 80$	$\Phi 80$	$\Phi 60$
RND径	$\Phi 250$	$\Phi 180$	$\Phi 180$	$\Phi 140$
層間	層間厚=60 μm		層間厚=60 μm	層間厚=40 μm
基材種	FR-4.0/4.1、低誘電材			

※貫通THは含まず/ハイスベック仕様には低誘電・高Tg材以上を推奨

生産能力 長野・大阪事業所計 6,000mi \rightarrow 18,000mi

高多層基板

項目	標準	チャレンジ	標準	チャレンジ
層数	16層	32層~54層	20層	40層~64層

※最大層数は層構成による/厚銅箔にも応相談

項目	標準	チャレンジ	標準	チャレンジ
L/S	100/100	75/75	75/75	-
基材種	FR-4.0/4.1、低誘電材			

※層構成/導体厚に準ずる

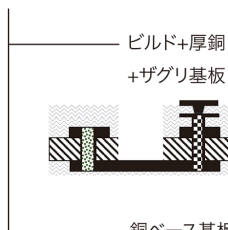
高周波基板



低誘電 or PTFE材
一般材等

項目	チャレンジ	標準	チャレンジ
基材種	ハイブリッド構造	ハイブリッド構造	ハイブリッド構造
	低誘電+FR-4等 PTFE+FR-4等	低誘電+FR-4	PTFE+低誘電

◆高放熱・モジュール



項目	2021年		2023年	
	標準	チャレンジ	標準	チャレンジ
L/S	500/500	500/250	500/250	900/100
銅箔厚	105	210	210	210

※厚銅層のみ

銅ベース基板



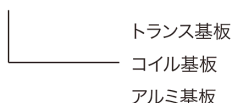
銅箔
絶縁層
銅板

項目	標準	チャレンジ	標準	チャレンジ
層数	1層	2層	-	-
銅箔厚	105	250	250	600

※配線層

※ベース層

◆大電流・厚銅・放熱



トランス基板
コイル基板
アルミ基板

	2021年		2023年	
	国内	海外	試作	少量産
海外	-	-	-	中・大量産/低コスト